

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江金连接科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



长江证券承销保荐有限公司
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED

（中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室）

二零二六年六月

声 明

作为浙江金连接科技股份有限公司（以下简称“金连接”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明，本文件所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人基本情况	3
二、发行人的主营业务.....	3
三、发行人的核心技术.....	4
四、发行人的研发水平	7
五、发行人主要经营和财务数据及指标	9
六、发行人存在的主要风险	9
第二节 本次证券发行情况.....	12
一、本次发行基本情况.....	12
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	13
三、保荐机构与发行人的关联关系情况	14
第三节 保荐机构承诺事项.....	16
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见	17
一、本次发行已履行必要的决策程序.....	17
二、发行人符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况	17
三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明.....	20
四、保荐机构的推荐结论	27
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排	28
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项	29
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.....	30

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	浙江金连接科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Goldlink Tech Co., Ltd.
注册资本	40,945,882.00 元
法定代表人	曹镭
有限公司成立日期	2017 年 7 月 21 日
股份公司成立日期	2021 年 12 月 22 日
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号
邮政编码	314033
联系电话	0573-83693388
传真号码	0573-83996399
互联网网址	www.goldlink-tech.com
电子信箱	IR@goldlink-tech.com
经营范围	研发、生产、销售精密机械加工零组件、电子测试探针零组件、电子连接器零组件、数据通信电缆线组件、光机电一体化产品、通信及计算机产品；金属材料的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人的主营业务

公司是一家全球知名的微细精密零件提供商，目前主要为 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等国内外知名芯片测试耗材厂商提供核心零件，产品最终应用于国内外主要芯片厂商 GPU、CPU、ASIC 等高端芯片的测试环节，是全球高端芯片供应链体系的重要一环。此外，公司亦积极拓展业务边界，战略性布局医疗器械精密零件和晶圆测试探针零件，持续丰富自身产品矩阵。

作为国内少数具备测试探针零件规模化制造能力的企业，公司可实现最小直径 0.03mm、尺寸公差 $\pm 2\mu\text{m}$ 的测试探针零件稳定批量生产，并能够在最小直径 0.04mm 的探针顶柱头完成复杂几何结构的镜面级加工，产品参数已全面对标甚至部分超越国外竞争对手产品。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024 年公司在测试探针零件行业的市占率位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。在高端芯片测试探针零件长期由境外厂商主导的产业背

景下，公司通过探针零件超精密微细加工、高效收集与清洗以及探针材料制备的全流程技术突破，成功量产高端芯片测试探针零件，成为国内芯片测试产业链中的“补链者”和“强链者”，为我国芯片产业的战略安全与竞争力提升奠定坚实基础。

截至本上市保荐书签署日，公司共拥有已授权专利 60 项，其中发明专利 30 项，并成功入选为国家级专精特新重点“小巨人”企业。此外，公司积极引领行业技术发展，“芯片测试用关键电子材料研发与产业化项目”被浙江省科技厅评定为 2023 年度浙江省“尖兵”研发攻关计划项目，“半导体芯片测试探针零件制造项目”入选浙江省产业链协同创新项目，公司产品“测试探针用合金精微部件”成功入选 2023 年度浙江省首批次新材料名单。公司先后被授予浙江省高新技术企业研究开发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、嘉兴市技术中心等荣誉称号，入选浙江省科技型中小企业、全国首批制造业新型技术改造试点城市试点项目。

三、发行人的核心技术

（一）核心技术概述

公司以市场及客户需求为导向，聚焦自主创新、技术突破，逐渐积累起较强的核心技术壁垒，并主要通过申请专利以及技术秘密的方式对相关技术进行保护，截至本上市保荐书签署日，公司掌握 13 项核心技术，取得了授权发明专利 30 项。目前，公司研发的各项核心技术主要应用于公司已量产的芯片测试探针零件及核心原材料钽合金棒材中，为公司经营规模不断增长起到了积极贡献。

具体来看，基于从微细零件材料至微细零件成品的全流程自主生产，公司构建了三大核心技术平台：高精度先进生产工艺技术平台、自动化收集与清洗技术平台以及超细高性能钽合金棒制备平台。以上平台协同作用，共同强化了公司在微细零件产品一致性、可靠性及生产效率方面的优势，形成了可持续的技术壁垒与核心竞争力。

对于高精度先进生产工艺技术平台，公司形成了精密刀具设计技术、刀具精密焊接定位技术、精密刀具磨削技术、机床同步稳定送料与无损导向技术等 8 项核心技术。针对芯片测试探针零件尺寸微细的特点，公司通过多年试验积累了大量刀具结构、角度的数据，并攻克了刀具精密焊接定位技术、精密刀具磨削技术，

可自主生产符合加工微米级尺寸精度要求的超精密刀具，在降低生产成本的同时，显著提升了切削质量与加工精度。在探针零件加工方面，公司通过对 CNC 机床进行自主改造，并自主研发配套工装，形成机床同步稳定送料与无损导向技术，实现了钽合金材料自动上下料、连续稳定加工，大幅提高生产效率。同时，利用自产刀具并结合自主开发的切削方案，形成包括高精度探针零件圆弧成型技术、高精度探针零件镜面劈花技术、高精度探针套筒圆弧收口技术、带皇冠头套筒一次成型技术等在内的一系列高精度车铣复合加工技术，有效提升了微细零件的精度及成品率。

对于自动化收集与清洗技术平台，面对微细零件在收集与清洗方面的挑战，公司开发了微细零件无损收集技术。该技术采用自研真空辅助回收系统，实现微细探针零件的高效回收，同时显著降低收集过程中因碰撞导致的良率损失。此外，公司还自主研发了微细精密零件清洗技术，利用自研特殊材质清洗罐，搭配多层嵌套复合清洗工艺，显著提高了清洗效率与零件品质。

对于超细高性能钽合金棒制备平台，公司形成了钽合金材料配方开发技术、精密拉丝模拉拔技术以及无损精矫技术。凭借以上技术，公司成功自主生产出超细高质量钽合金棒，其硬度、电阻率、杨氏模量及抗拉强度等多项性能参数显著优于同类竞品，并能够实现优异的直线度、圆度、一致性和表面光洁度，为后续高精度机加工奠定材料基础。

以上核心技术均应用于公司已量产的芯片测试探针零件及其核心原材料钽合金棒材中，为公司经营规模的不断增长起到了积极作用。

（二）核心技术的先进性及具体表征

核心技术平台名称	核心技术名称	技术来源	核心技术描述	核心技术先进性
超细高性能钽合金棒制备平台	钽合金材料配方开发技术	吸收创新	基于钽-铜-银三元体系，持续优化材料配比与微量元素配方，改进熔铸及定向凝固工艺，提升材料机械强度、导电性与成型性	所开发钽合金综合性能优异，机械与电气关键指标达到业内领先水平

核心技术平台名称	核心技术名称	技术来源	核心技术描述	核心技术先进性
	精密拉丝模拉拔技术	自主研发	采用自主开发精密拉丝模,通过多次渐进拉拔工艺,制备高圆度、高一一致性的超细钽合金棒材	可稳定制备直径 $<1\text{mm}$ 、圆度公差 $\pm 1\mu\text{m}$ 的超细高精度钽合金棒材,表面粗糙度 $\text{Ra}<0.05\mu\text{m}$ 达到类镜面效果,尺寸精度与一致性水平处于行业领先地位,是实现探针零件最小外径与高精度的关键保障之一
	无损精矫技术	自主研发	自主研发无损精矫工艺,在不损伤材料表面与内部组织的前提下,精准矫正棒材弯曲,显著提升成品直线度与平直度	实现直线形位公差 $<0.05\text{mm/m}$ 的高直线度,满足精密零件加工对棒材直线度的严苛使用要求
高精度先进生产工艺技术平台	精密刀具设计技术	自主研发	自主设计用于微细零件加工的超精密车铣刀具,设计内容涵盖刀具结构、刃口角度、排屑槽型等多项关键要素;针对劈花铣刀,围绕动平衡、圆跳动等指标开展专项结构优化设计,为刀具的优异动态性能奠定结构基础	自主设计的刀具结构能够满足微细精密零件的稳定加工要求;劈花铣刀通过专项结构优化,有效保障加工尺寸的高一致性以及无振纹、无毛刺的表面质量,加工的微细零件可达到镜面级表面光洁度
	刀具精密焊接定位技术	自主研发	自研高精度多自由度焊接定位系统,可实现微细刀具组件微米级精准对位与高质量精密焊接	可实现秒级旋转微调、微米级平移定位与多角度倾斜调节,定位精度达到行业先进水平
	精密刀具磨削技术	自主研发	自研辅助夹持工装和高精度磨削工艺,有效抑制高速磨削过程中共振问题,制备的车铣刀具可满足超精密微细加工要求	实现刀具平面度 $\leq 0.015\mu\text{m}$ 、左右刀面的表面粗糙度 $\leq 0.05\mu\text{m}$,刃径公差 $\pm 10\mu\text{m}$ (特殊 $\pm 5\mu\text{m}$)、角度公差 $\leq 0.3^\circ$ (特殊 $\leq 0.2^\circ$)
	机床同步稳定送料与无损导向技术	自主研发	自主开发进给控制工装与精密导向部件,实现超细棒材连续稳定送料、高速旋转工况下无损伤稳定加工	实现超细棒材超高速旋转下的平稳精密加工,是实现加工零件最小直径和尺寸公差的关键因素之一
	高精度探针零件圆弧成型技术	自主研发	采用自研的超精密刀具与微细零件圆弧加工工艺,实现探针底柱头的高精度圆弧成型,圆弧过渡光滑且连续,有效保障测试接触的稳定性与可靠性	最小加工外径 0.03mm 、最小外径加工公差 $\pm 2\mu\text{m}$;圆弧表面粗糙度 $\text{Ra}<0.05\mu\text{m}$,达到类镜面效果
	高精度探针零件镜面劈花技术	自主研发	采用自研的超精密劈花刀具和微细零件劈花加工工艺,实现探针顶柱头一次劈花成型,所制皇冠头达到镜面级表面光洁度,保证芯片测试接触面电阻稳定维持在较低水平、高频次测试的信号传输准确性	最小加工外径 0.03mm 、最小外径加工公差 $\pm 2\mu\text{m}$;可实现最小尺寸 0.04mm 的皇冠头加工;皇冠头内壁表面粗糙度 $\text{Ra}<0.025\mu\text{m}$,达到镜面效果
	高精密切探针套筒圆弧收口工艺	自主研发	采用自研的超精密刀具与圆弧收口工艺,有效抑制薄壁套筒收口变形、毛刺缺陷,确保圆弧过渡面光滑连续、无微观裂纹,实现测试信号稳定高效传导	外径表面粗糙度达到 $\text{Ra}<0.05\mu\text{m}$ 的类镜面效果;圆弧收口过渡面光滑,表面粗糙度达到 $\text{Ra}<0.05\mu\text{m}$ 的类镜面效果

核心技术平台名称	核心技术名称	技术来源	核心技术描述	核心技术先进性
	带皇冠头套筒一次成型技术	自主研发	采用自研精密模具与一体复合加工工艺, 实现皇冠头与套筒整体成型, 消除分体式结构固有装配偏差, 显著提升产品尺寸一致性与整体精度	省去组装成本、大幅降低装配废品率, 皇冠头内壁表面粗糙度 $Ra < 0.025\mu m$, 达到镜面效果, 尺寸一致性与装配精度满足高端芯片测试探针的严苛要求
自动化收集与清洗技术平台	微细零件无损收集技术	自主研发	基于 CNC 机床适配开发真空辅助回收系统, 采取真空吸附与双路气动协同控制结构, 实现微细零件与切削油的高效分离, 最终实现微细零件自动化、无损伤高效收集	无损综合回收率 $\geq 98\%$, 显著提升生产良率与回收稳定性
	微细零件清洗技术	自主研发	自研特殊材质清洗罐, 搭配多层嵌套复合清洗工艺, 保障清洗剂顺畅循环, 实现微细零件深度除污、低冲击、高回收率的高效洁净清洗	实现微细探针零件深度洁净清洗, 杜绝碰撞损伤与零件丢失, 有效解决行业清洗痛点, 满足高端精密零件严苛洁净度要求

四、发行人的研发水平

(一) 报告期研发投入情况

报告期各期, 公司的研发投入情况如下:

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用 (万元)	2,061.67	1,061.17	971.76
营业收入 (万元)	27,628.15	15,815.29	9,125.36
研发费用占营业收入比例	7.46%	6.71%	10.65%

(二) 发行人正在从事的研发项目

目前, 公司正在从事的研发项目及进展情况如下:

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标
1	电铸微细管的研发	在研	实现内径 0.08-0.24mm、外径 0.1-0.27mm、长度尺寸公差 $\leq \pm 0.01mm$ 、硬度 375-450HV、表面粗糙度 $Ra \leq 0.05\mu m$
2	芯片测试探针弹簧的研发	在研	实现线径 $\varphi 0.02mm$ 、外径 $\varphi 0.08mm$ 尺寸, 满足尺寸公差 $\leq \pm 5\mu m$ 、表面粗糙度 $Ra \leq 0.03\mu m$ 、疲劳寿命 ≥ 100 万次、弹力波动 $\leq 3\%$
3	晶圆检测探针加工工艺的研发	在研	实现表面粗糙度 $Ra \leq 0.05\mu m$ 、尺寸公差 $\leq \pm 0.5\mu m$ 、锥度误差 $\leq 1\mu m/m$ 、批量合格率 $\geq 99\%$, 适配 7nm 及以下先进制程
4	高精密钨合金 Kelvin 头组合铣刀的研发	在研	实现镜面级表面光洁度、尺寸公差 $\leq \pm 2\mu m$, 刀具寿命提升 30%
5	高精密背轴回收系统自动收	在研	研发自动收集导管, 实现损耗率 $\leq 1\%$ 、切削

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标
	集导管的研发		油排出速度 $\geq 5\text{ml/s}$ 、吸附成功率 $\geq 99.9\%$
6	高精密极小铍铜合金探针铣面加工工艺的研发	在研	实现镜面级表面光洁度、加工合格率 $\geq 99\%$
7	医用钯铂合金消融头微小孔精准加工设备改造的研发	在研	改造设备实现无导套加工，孔径公差 $\leq \pm 0.02\text{mm}$ 、表面粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 、合格率 $\geq 99.6\%$
8	48Pd-42Cu-10Ni 合金材料研发	在研	研发无银抗沾锡合金材料，实现维氏硬度 $\geq 450\text{HV}$ 、电阻率 $\leq 14\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、抗沾锡测试 ≥ 5000 次
9	钯基电接触合金材料研发	在研	开发符合 ASTM B540-21 标准的 P7 钯基合金材料，实现维氏硬度 330-400HV、电阻率 $\leq 31.6\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、接触电阻 $\leq 50\text{m}\Omega$
10	高端贵金属棒料表面缺陷综合抑制与精密成形关键技术研究	在研	实现表面缺陷综合抑制率 $\geq 95\%$ ，表面粗糙度 $Ra \leq 0.1\mu\text{m}$ （医疗级）、 $Ra \leq 0.2\mu\text{m}$ （芯片级），尺寸公差 $\leq \pm 0.01\text{mm}$ ，成品合格率 $\geq 98\%$ ，材料利用率 $\geq 95\%$ ，生产效率提升 $\geq 20\%$
11	$Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 级半导体测试探针皇冠头超精加工关键技术研发	在研	实现皇冠头锥面粗糙度 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ ，尺寸精度 $\leq \pm 2\mu\text{m}$
12	超导级低损耗银铜合金（10%Ag）关键制备技术研发	在研	实现电阻率 $2-3\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、抗拉强度 880-930MPa、维氏硬度 250-300HV，导电率 $\geq 80\%$ IACS；批量合格率 $\geq 98\%$ 、材料利用率 $\geq 95\%$
13	精密测试探针 SK4 材料底柱头精密加工工艺的研发	在研	实现 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ 、尺寸精度 $\leq \pm 3\mu\text{m}$ 、CPK ≥ 1.33
14	医疗贵金属弹簧圈的研发	在研	产品无菌，污染指数 ≤ 90 ，环氧乙烷灭菌残留量 $\leq 10\mu\text{g/g}$ ，细菌内毒素含量 $\leq 20\text{EU/件}$ ，产品物理性能应满足标准 YY/T 1748 的要求，产品的化学性能应满足 GB/T 14233.1 的要求
15	超细铂钨合金丝生产工艺的研发	在研	实现线材直径 0.02-0.05mm、尺寸公差 $\leq \pm 2\mu\text{m}$ 、抗拉强度 $\geq 1100\text{MPa}$ ，表面光滑无缺陷，生物相容性符合 ISO 10993 医用植入级要求
16	超细铂铱合金丝生产工艺的研发	在研	实现线材直径 0.02-0.05mm、尺寸公差 $\leq \pm 2\mu\text{m}$ 、抗拉强度 $\geq 1100\text{MPa}$ ，表面光滑无缺陷，生物相容性符合 ISO 10993 医用植入级标准
17	高精密钯合金多点接触 Kelvin 皇冠头探针的研发	在研	实现多点对称 Kelvin 四线法接触，接触区锥面 $Ra \leq 0.1\mu\text{m}$ ，尺寸公差 $\leq \pm 2\mu\text{m}$ ，产品合格率 $\geq 97\%$ ，生产效率提升 $\geq 15\%$
18	精密探针加工用同轴无损伤后轴夹头研发	在研	实现夹持同轴度 $\leq 0.005\text{mm}$ 、重复定位精度 $\leq 2\mu\text{m}$ 、使用寿命 ≥ 50 万次，适配 $\Phi 0.1-\Phi 0.5\text{mm}$ 微细探针，夹持无划伤、无压痕、无变形；探针零件报废率下降 $\geq 60\%$ 、装夹时间缩短 $\geq 20\%$

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标
19	AI 质量检测预测模型研发	在研	基于视觉检测算法实现不良检出率 $\geq 99\%$ 、漏检率 $< 1\%$ ，基于结构化数据的良品分类模型预测准确率 $\geq 90\%$ ，提升 $\geq 50\%$ 人工质检效率，实现缺陷自动识别、分级、溯源与质量隐患提前预测，满足高端探针规模化生产的高精度、标准化智能质量检测需求

五、发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2025.12.31 或 2025 年度	2024.12.31 或 2024 年度	2023.12.31 或 2023 年度
资产总额（万元）	71,018.06	66,462.08	44,806.63
归属于母公司所有者权益（万元）	41,627.70	35,929.63	20,889.51
资产负债率（母公司）（%）	40.30	45.70	53.31
营业收入（万元）	27,628.15	15,815.29	9,125.36
净利润（万元）	5,868.82	524.12	-475.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,868.82	524.12	-475.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,147.13	-21.18	-990.09
基本每股收益（元）	1.43	0.14	-0.13
稀释每股收益（元）	1.43	0.14	-0.13
加权平均净资产收益率（%）	15.13	2.13	-2.23
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,510.21	4,712.14	3,248.23
现金分红（万元）	-	-	2,000.00
研发投入占营业收入的比例（%）	7.46	6.71	10.65

六、发行人存在的主要风险

（一）客户集中度高的风险

报告期各期，公司前五大客户销售收入占公司当期营业收入比例分别为 63.90%、76.10%和 80.82%。其中，公司向第一大客户 Smiths Interconnect 的销售金额分别为 3,368.19 万元、7,836.38 万元和 13,231.22 万元，占营业收入的比例分别为 36.91%、49.55%和 47.89%，占比较高。

2026 年 4 月 Smiths Interconnect 的控股方从英国史密斯集团变更为美国莫仕电子技术控股有限公司（Molex）。若未来发行人现有主要客户，尤其是第一大客户 Smiths Interconnect 发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行

业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，进而减少对发行人产品的采购，而发行人未能及时开拓新客户，则将对发行人盈利能力产生重大不利影响。

（二）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为-990.09 万元、-21.18 万元和 5,147.13 万元。公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观经济、市场环境、下游行业景气度、主要客户业务发展情况以及新客户拓展情况等多方面因素的影响。若半导体行业景气度出现周期性波动，使得芯片测试市场需求持续低迷、市场竞争愈发激烈，或新客户开拓不及预期、重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致芯片测试探针零件出现售价下降、销售量降低等不利情形，则公司经营业绩将面临下滑的风险。

（三）核心技术泄密风险

公司在微细精密零件领域深耕超二十年，通过长期的技术研发掌握了多项微细精密零件及核心原材料生产制备的核心技术，并实现产业化。核心技术是公司的核心竞争力之一，系公司可持续发展的重要保证，公司通过申请专利、与研发人员签署保密协议等方式对关键核心技术进行保护。如果公司核心技术泄密，将对公司在行业内的竞争力造成不利影响。

（四）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 5,666.47 万元、5,739.11 万元和 5,956.92 万元，主要包括原材料、库存商品和在产品。公司存货跌价准备分别为 1,102.04 万元、1,190.82 万元和 1,339.63 万元，总体呈增长趋势，主要是由于战略备货等因素导致公司部分存货库龄增长。公司根据客户订单及预测需求提前采购各类原材料并组织生产，但由于下游半导体封测行业更新换代速度较快，公司存货面临着一定的跌价风险。

（五）宏观经济波动和行业周期性的风险

报告期各期，发行人芯片测试探针零件的销售收入分别为 6,583.11 万元、12,112.76 万元和 22,385.63 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 77.74%、85.56% 和 92.14%，下游客户主要集中在芯片测试领域，受半导体行业发展的影响较大。

半导体行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气度会随着宏观经济周期出现波动。若全球经济出现衰退，将对半导体行业相关产品造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

第二节 本次证券发行情况

一、 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 13,650,000 股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 13,650,000 股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	/
发行后总股本	不超过 54,595,882 股（不含使用超额配售权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（发行价格除以发行后每股收益）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润（如有）	不适用		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式		
发行对象	符合中国证监会、上交所规定的资格的询价对象和符合投资者适当性要求且在上交所开立科创板账户的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	半导体芯片检测用探针零件扩产项目		
	医疗器械精密零件制造基地建设项目		
	研发中心升级项目		
	补充流动资金		

发行费用概算	保荐承销费用【】万元，审计费用【】万元，律师费用【】万元，与本次发行相关的信息披露费用【】万元，发行手续费及其他费用【】万元，发行费用合计【】万元（以上费用均不含增值税）
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	无

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》，授权保荐代表人李娜和张崇军担任浙江金连接科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，具体负责金连接本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜，上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李娜女士，保荐代表人，注册会计师，曾主持或参与和达科技（688296）、和顺科技（301237）、麟龙科技等 IPO 项目、嘉兴丝绸（002404）再融资项目等。李娜女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

张崇军先生，保荐代表人，曾主持或参与飞力达（300240）重大资产重组项目以及和达科技（688296）、和顺科技（301237）、万丰股份（603172）、通领科技（920187）等 IPO 项目。张崇军先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为金晓荣，其保荐业务执业情况如下：

金晓荣先生，保荐代表人，注册会计师，曾参与和达科技（688296）IPO 项

目、联迪信息（839790）、通领科技（920187）北交所项目，具有扎实的金融知识基础，熟悉证券市场法规。

项目组其他成员为李坤和郑玮辰。

（四）保荐机构联系地址、电话和其他通讯方式

联系地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层

联系人：李娜、张崇军

联系电话：021-65779433

（五）发行人基本情况

中文名称	浙江金连接科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Goldlink Tech Co., Ltd.
注册资本	40,945,882.00 元
法定代表人	曹镭
有限公司成立日期	2017 年 7 月 21 日
股份公司成立日期	2021 年 12 月 22 日
住所	浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号
邮政编码	314033
联系电话	0573-83693388
传真号码	0573-83996399
互联网网址	www.goldlink-tech.com
电子信箱	IR@goldlink-tech.com
经营范围	研发、生产、销售精密机械加工零组件、电子测试探针零组件、电子连接器零组件、数据通信电缆线组件、光机电一体化产品、通信及计算机产品；金属材料的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、保荐机构与发行人的关联关系情况

保荐机构及本次证券发行的保荐代表人经对发行人及其关联方与本保荐机构及其关联方的利害关系进行审慎核查，保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形，具体如下：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

发行人的保荐机构将安排相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人权益、在发行人任职等情况。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

第三节 保荐机构承诺事项

一、保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

二、保荐机构同意推荐浙江金连接科技股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

三、保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受上海证券交易所的自律监管。

第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、本次发行已履行必要的决策程序

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

1、2025年12月2日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，全体董事出席会议。该次会议审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

2、2025年12月19日，发行人召开了2025年第二次临时股东会，全体股东出席会议，审议通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

依据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

二、发行人符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况

（一）发行人符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	根据《战略性新兴产业分类（2018）》，芯片测试探针零件属于新一代信息技术产业中“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制”，因此属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路领域”。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性指标要求

科创属性相关指标	是否符合	公司具体情况
最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在8000万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023年度、2024年度和2025年度，公司研发费用分别为971.76万元、1,061.17万元和2,061.67万元，最近三年，研发投入占营业收入比例7.79%。
研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2025年12月31日，公司的研发人员为56人，占员工总数的比例为14.36%，超过10%。
应用于公司主营业务的发明专利7项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本上市保荐书签署日，应用于公司主营业务的发明专利共30项，超过7项。
最近三年营业收入复合增长率达	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023年度、2024年度和2025年度，营业收

科创属性相关指标	是否符合	公司具体情况
到 25%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元		入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，复合增长率为 74.00%，超过 25%。

(三) 发行人符合科创板支持方向

1、公司符合国家科技创新战略

2021 年 3 月，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出“从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。”

公司主营业务为微细精密零件的研发、生产和销售，目前聚焦于芯片测试探针零件领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“鼓励类”产业。

2、公司科技创新能力突出

公司秉承市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有完整的技术布局，并且形成了较强的自主创新能力和规模化工艺开发能力。

基于高效的研发体系，公司取得了丰富的研发成果。截至本上市保荐书出具日，公司共拥有已授权专利 60 项，其中发明专利 30 项，并成功入选为国家级专精特新重点“小巨人”企业。此外，公司积极引领行业技术发展，“芯片测试用关键电子材料研发与产业化项目”被浙江省科技厅评定为 2023 年度浙江省“尖兵”研发攻关计划项目，“半导体芯片测试探针零件制造项目”入选浙江省产业链协同创新项目，公司产品“测试探针用合金精微部件”成功入选 2023 年度浙江省首批次新材料名单。公司先后被授予浙江省高新技术企业研究开发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、嘉兴市技术中心等荣誉称号，入选浙江省专精特新

中小企业、浙江省科技型中小企业、全国首批制造业新型技术改造试点城市试点项目。

3、公司市场认可度高

公司紧抓全球半导体与 AI 行业的发展机遇，依托高标准的制造与管理体系，成功进入多家行业头部客户的供应链，并在交付能力、质量与技术等方面获得了国内外一流客户的高度认可。目前，公司测试探针零件已稳定供应于 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等全球知名芯片测试探针及插座厂商，并最终应用于国内外主要芯片厂商的高端 GPU、CPU、ASIC 等芯片测试服务中。

（四）保荐机构核查过程及核查结论

1、了解研发费用的支出范围和归集方法，分析归集的完整性及准确性；结合发行人的研发项目情况，核查发行人的研发支出是否符合研发费用的支出范围，研发费用归集是否真实、准确；

2、查阅发行人花名册以及各部门人员；访谈发行人人力资源部负责人，了解公司各部门人员构成；

3、查阅发行人发明专利证书，前往专利登记机构查询专利情况；访谈发行人实际控制人，查阅发明专利的具体内容，了解公司发明专利具体应用情况。

4、访谈发行人财务总监，了解发行人的收入确认政策；获取发行人主要客户合同并对主要客户进行访谈，核查发行人的收入确认政策是否符合合同条款及业务实质，分析收入确认政策的合理性；

5、执行收入及研发费用截止性测试，核查收入及研发费用是否计入了恰当的会计期间，是否存在跨期的情况。

6、执行收入细节测试，检查收入相关的合同或订单、发货单、签收单、发票，核查收入的真实性、准确性；函证并走访主要客户，核实报告期各期的交易金额；执行收入截止性测试，核查收入是否计入了恰当的会计期间，是否存在跨期的情况；执行分析性程序，对收入变动合理性进行分析。

7、访谈发行人客户，了解其对发行人产品的评价情况；访谈发行人实际控

制人，了解公司的行业排名，行业内主要企业的业务规模；

8、查阅与分析《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》《战略性新兴产业分类（2018）》，核查发行人的行业归属情况；查阅可比公司的行业领域归类，核查发行人与可比公司是否存在显著差异；查阅行业研究报告、同行业可比公司招股说明书，了解公司所处行业的竞争格局及公司在行业内的地位。

经核查，保荐机构认为发行人符合国家产业政策，符合科创属性和科创板定位要求。

三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

保荐机构依据《证券法》第十二条关于首次公开发行新股的条件，对发行人的情况进行逐项核查，并确认：

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构；

发行人已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东会、董事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、董事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。2025年10月，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

（2）发行人具有持续经营能力；

根据发行人的说明、发行人审计机构天健会计师对发行人最近三年财务会计报告出具的无保留意见的《审计报告》、发行人正在履行的重大经营合同及本保荐机构的适当核查，保荐机构认为：发行人公司是一家专业从事微细精密零件及

核心原材料研发与制造的高新技术企业，公司所处行业发展前景稳定，市场开拓具有可持续性。公司具有良好的行业地位，技术及研发能力较强，生产经营良好，财务状况良好，业务运行规范，发展目标清晰，市场竞争力较强，因此公司具备持续经营能力。综上，发行人符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；

根据发行人审计机构天健会计师出具的《审计报告》《内部控制审计报告》及本保荐机构的适当核查，发行人已取得由天健会计师出具的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕4453号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕4454号）。发行人符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

根据发行人说明、相关政府机构出具的证明及保荐机构适当核查，发行人及其控股股东、实际控制人曹镭最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形。发行人符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

（5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

经保荐机构核查，发行人不存在违反经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件的情形，符合《证券法》第十二条第（五）项的规定。

2、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明

（1）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

查证过程及事实依据如下：

经核查发行人全部工商档案资料，浙江金连接科技股份有限公司系浙江金连接科技有限公司（以下简称“金连接有限”）以整体变更方式设立，金连接有限

成立于 2017 年 7 月 21 日。

2021 年 11 月 20 日，经金连接有限股东会决议同意，金连接有限以 2021 年 10 月 31 日为审计评估基准日整体变更设立股份公司。

2021 年 12 月 3 日，金连接有限召开股东会，确认天健会计师出具的“天健审〔2021〕8695 号”《审计报告》，金连接有限截止 2021 年 10 月 31 日经审计的净资产为 88,854,078.06 元；全体股东一致同意，变更后的股份有限公司的注册资本为 34,285,714.00 元，股份总数为 34,285,714 股，每股 1 元。各发起人以经审计后的账面净资产 88,854,078.06 元按 2.59: 1 的比例折合成公司股份 34,285,714 股，其中 34,285,714.00 元计入注册资本，余额 54,568,364.06 元计入资本公积。

2021 年 12 月 13 日，金连接有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》，一致同意将金连接有限以净资产折股并整体变更为股份有限公司。

2021 年 12 月 19 日，金连接召开创立大会暨第一次股东大会并决议通过了整体变更方案。

2021 年 12 月 22 日，嘉兴市市场监督管理局核准了金连接有限本次整体变更事项。

本保荐机构认为：发行人是依法设立且从有限责任公司成立之日起计算持续经营 3 年以上的股份有限公司，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定。

(2) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

查证过程及事实依据如下：

根据发行人的相关财务管理制度、申报会计师出具标准无保留意见的天健审

(2026) 4453 号《审计报告》，并核查发行人的原始财务报表，本保荐机构认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。根据申报会计师出具的天健审〔2026〕4454 号《内部控制审计报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性，最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。经核查发行人的内部控制流程及其运行效果，本保荐机构认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审核报告。

综上，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定。

(3) 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

查证过程及事实依据如下：

经查阅发行人核心生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料并实地核实，发行人具备与生产经营相关且独立于实际控制人或其他关联方的生产运营系统、辅助业务系统和相关配套设施，发行人具有开展业务所需的资质、设备、设施，发行人全部资产均由公司独立拥有和使用，不存在资产被实际控制人占用的情形。

经与控股股东、实际控制人曹镭、高级管理人员以及业务人员访谈，并实地核实，发行人拥有从事主营业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产。发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的采购、生产、销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力和经营决策权，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。

经核查《公司章程》、股东会、董事会决议等资料中有关董事、监事、高级管理人员任免的内容，发行人董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。发行人董事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人干预公司董事会和股东会已经做出的人事任免决定的情况。发行人高级管理人员以及财务人员均专职在发行人工作

并领取薪酬，不存在违规兼职的情形。

经与高级管理人员和财务人员访谈，查阅发行人财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，发行人实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。发行人设立了独立银行账户，不存在与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户的情形。发行人作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

经核查发行人的三会记录，发行人根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东会、董事会严格按照《公司章程》规范运作，股东会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在股东干预公司机构设置的情形。2025年10月，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

发行人控股股东、实际控制人为自然人曹镭。经查阅发行人实际控制人关联方调查表及公开信息检索，核查曹镭及其关联方控制的其他企业实际经营情况及与发行人关联交易发生必要性、定价公允性，确认上述企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查发行人《公司章程》、股东会、董事会决议等资料中有关董事、监事、高级管理人员任免的内容，查阅发行人全部工商档案资料及相关人员出具的承诺函，了解其所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况，并与发行人管理层进行多次访谈，本保荐机构认为：发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员基本稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所

持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

经核查发行人专利、商标等无形资产以及核心生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料，复核了专利权、商标权的权利期限情况，通过公开检索和银行、主要供应商函证，核查了发行人主要债务、对外担保、诉讼、仲裁等或有事项，通过走访主要客户，分析发行人所处行业竞争态势，本保荐机构认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定。

(4) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

查证过程及事实依据如下：

经取得发行人主要股东、董事和高级管理人员调查表并对上述人员进行访谈，取得上述人员的《个人信用报告》、《无犯罪记录证明》，查阅工商登记资料，核查主要股东及董事和高级管理人员出具声明与承诺；取得发行人及子公司《企业信用报告》、相关政府机构出具的合规证明以及公开信息查询，本保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，本保荐机构认为：发行人本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件。

(二) 发行后股本总额不低于 3,000 万元

截至本上市保荐书出具日，发行人注册资本为 40,945,882 元，保荐机构认为，

发行人符合上述规定。

(三) 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

本次发行前公司的总股本为 40,945,882 股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 13,650,000 股，本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例不低于 25%。保荐机构认为，发行人符合上述规定。

(四) 市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人申请在上海证券交易所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

(一) 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

(二) 预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

(三) 预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

(四) 预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

(五) 预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

发行人选择的上市标准为市值及财务指标（一）。

查证过程及事实依据如下：

(1) 2026 年 1 月 29 日，惟明投资与远宁之鑫、杭州科祥、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹签订《股份转让协议》，约定将其持有公司 1,028,572 股股份以每股 61.0562 元的价格转让给上述 7 名受让人。2026 年 1 月 29 日，海南

嘉旭与原永丹、陈莉莉签订《股份转让协议》，约定将其持有公司 100,000 股股份以每股 61.0562 元的价格转让给上述 2 名受让人。上述转让系发行人原股东以整体估值 25 亿元为依据确定股权转让价格。

此外保荐机构已出具《关于浙江金连接科技股份有限公司预计市值的分析报告》，发行人预计市值不低于 10 亿元；

(2) 根据天健会计师出具的天健审(2026)4453 号《审计报告》，发行人 2025 年净利润 5,147.13 万元，营业收入人民币 27,628.15 万元，超过人民币 1 亿元。

综上，保荐机构认为，发行人符合“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”之要求，适用市值及财务指标（一）。

四、保荐机构的推荐结论

本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，认为发行人符合申请首次公开发行股票并在科创板上市的条件，且本次公开发行股票履行了《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关决策程序。本保荐机构同意推荐浙江金连接科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

第五节 对发行人持续督导期间的工作安排

持续督导事项	具体安排
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求； 2、确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其各项义务； 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 4、持续关注上市公司对信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度的执行情况。
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务充分了解； 2、关注主要原材料供应或者产品销售是否出现重大不利变化；关注核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况及其他竞争者的竞争情况； 3、关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持上市公司股权被质押、冻结情况； 4、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照上市规则规定履行核查、信息披露等义务	1、通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项； 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项； 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告	1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，披露持续督导跟踪报告； 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50%以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
6、持续督导期限	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导

第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项


保荐机构无其他需要说明事项。

第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论


保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为浙江金连接科技股份有限公司申请其股票上市符合《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。长江证券承销保荐有限公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

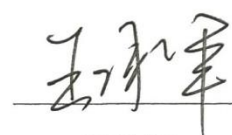
(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江金连接科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: 
金晓荣

保荐代表人:  
李娜 张崇军

内核负责人: 
王婵媛

保荐机构法定代表人、总经理: 
高稼祥

保荐机构董事长、保荐业务负责人: 
王承军

